

Unitech Printed Circuit Board Corp.

耀華電子股份有限公司

中華民國台灣新北市土城區中山路四巷3號

Tel : +886-2-22685071
FAX : +886-2-22687824

www.pcbut.com.tw

2025/12/12

吳錦芳

副總經理 / 發言人

TEL : +886-2-2268-5071

Email : kanty-wu@pcb.com.tw

Unitech

耀華電子股份有限公司

Unitech Printed Circuit Board Corp.

劉長寧

高級專員 / 代理發言人

TEL : +886-2-2268-5071

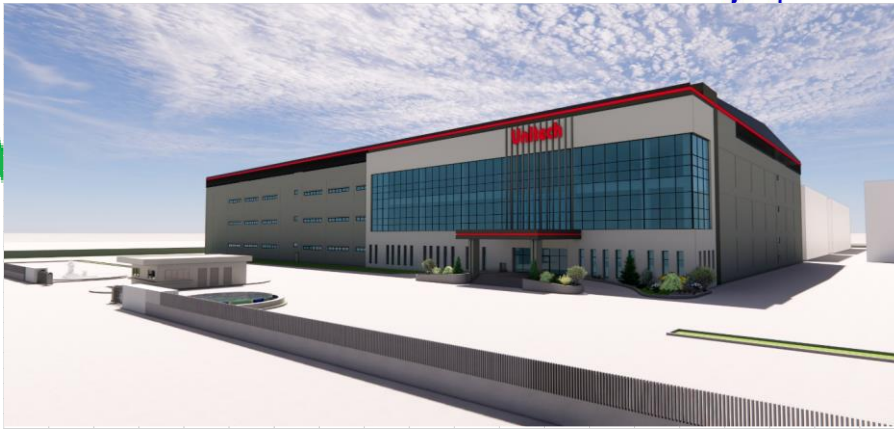
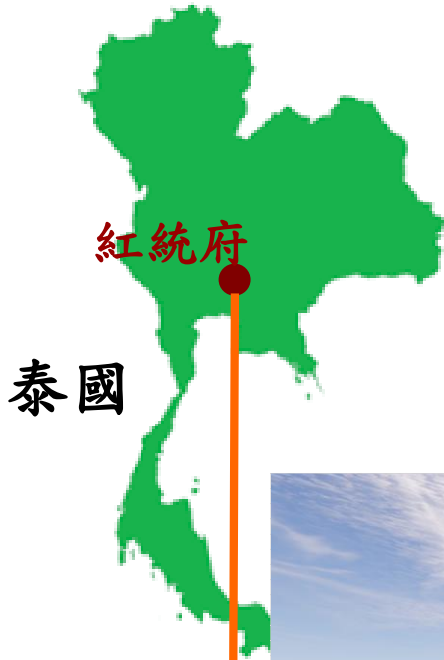
Email : Charlie-liou@pcb.com.tw

免責聲明

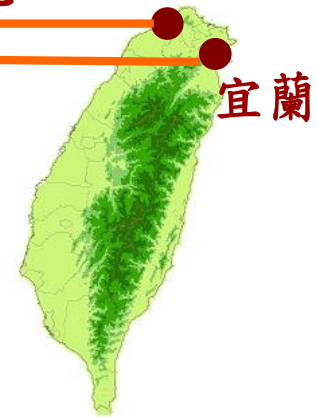
- 我們對報告內容或基於本報告的任何行為概不負責，也不作任何明示或暗示的保證或承諾。 Unitech或其任何一名員工均不對本報告文稿中包含或不包含的信息的完整性或準確性承擔責任。該報告文稿不包括或不構成任何提議的一部分，也不構成或構成任何種類計畫說明書的一部分。
- 本報告文稿包含一些未來性陳述。實際結果可能與這些未來性陳述中預測或暗示的情況大不相同。未來性信息涉及可能對預期結果產生顯著影響的風險和不確定性。
- 本報告的內容屬於機密性質，且所有內容由耀華保留其所有權。

Factory Location

Unitech



台北



Unitech

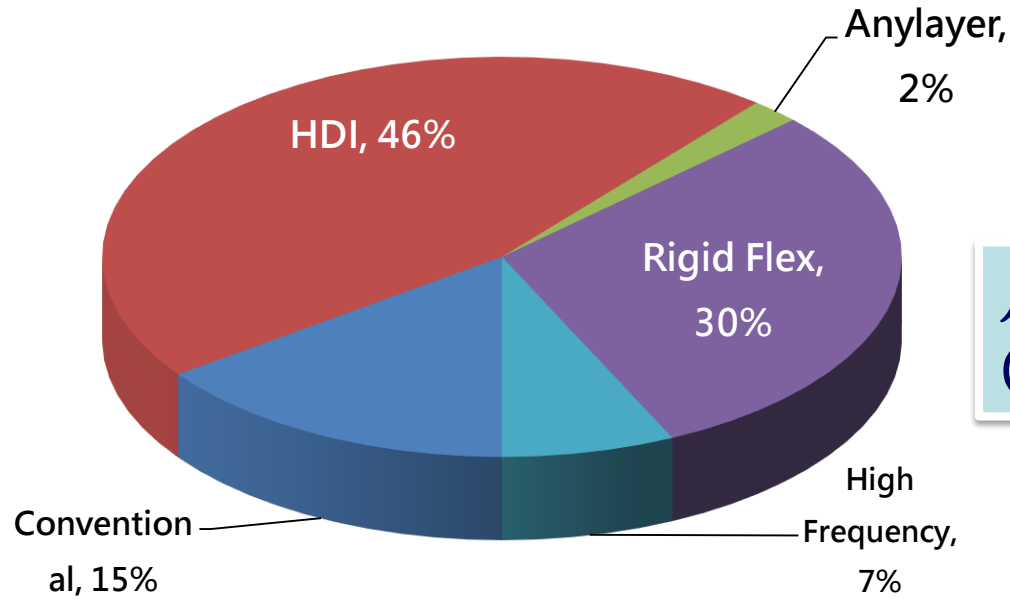


公司基本資料

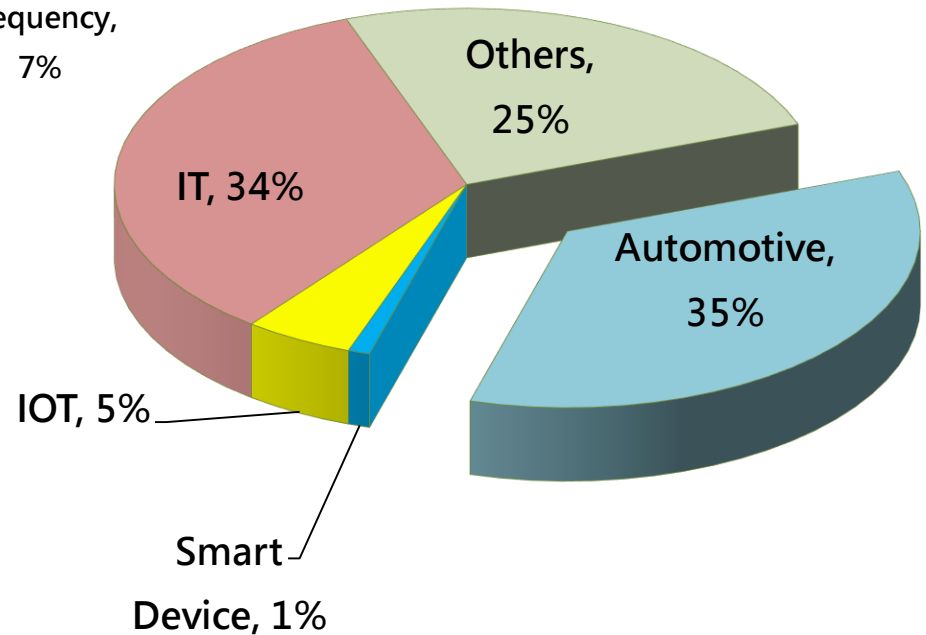
	台灣	上海展華(南通)	耀華(泰國)
資本額(2025/3Q)	7,062,532	4,352,143	1,514,560
總資產(2025/3Q)	22,596,895	7,848,632	1,636,893
成立時間	1984	2018	2024
產能(SF/月)	1300K	800K	300K
員工數	4600	1500	200

1. 資本額及總資產計算單位為新台幣仟元。
2. 人民幣兌新台幣匯率以4.2710計。
3. 泰銖兌新台幣匯率以0.9466計。

產品銷售分類-以技術別區分 (2025 2H)



產品銷售分類-以應用別區分 (2025 2H)



核心產品

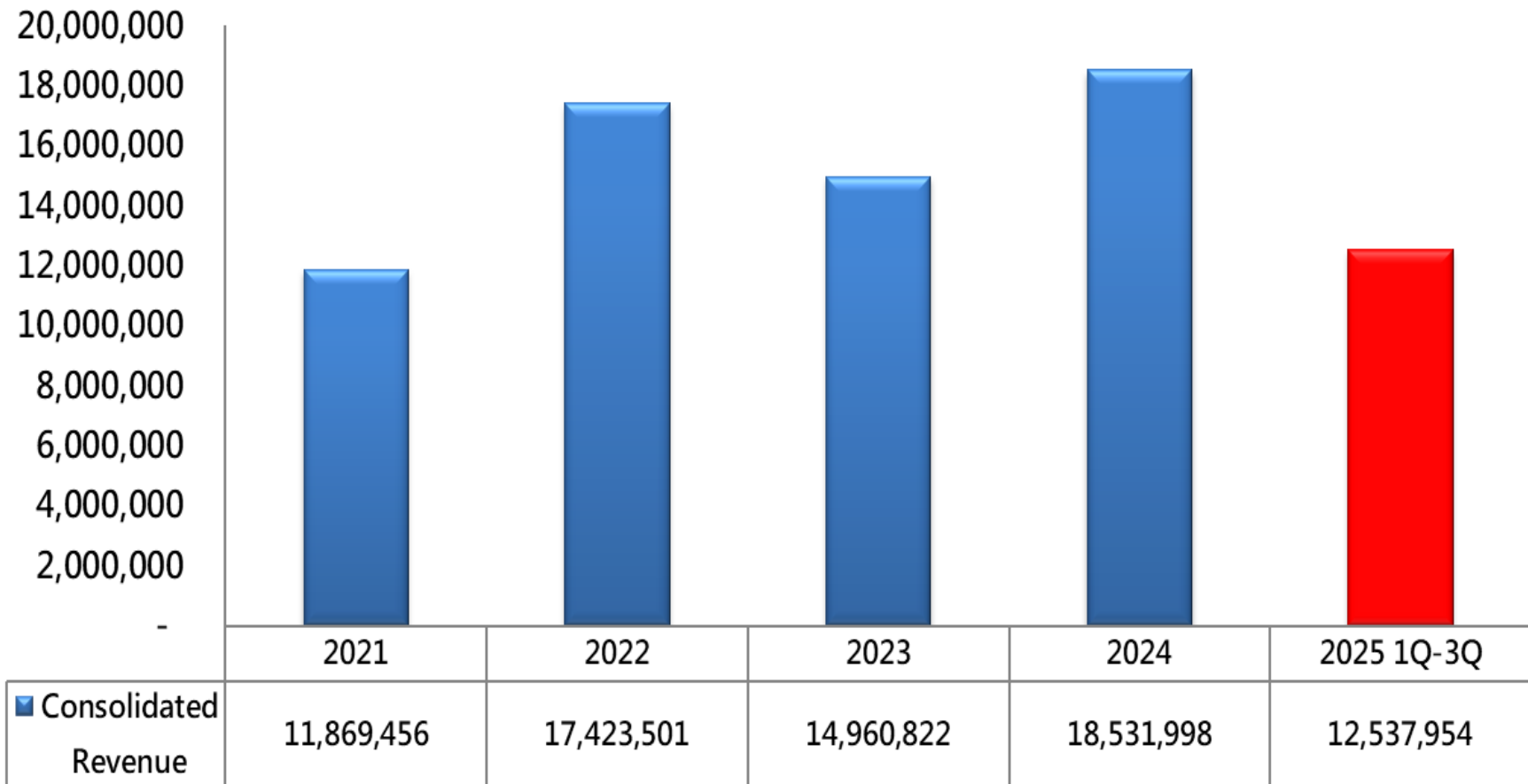
項目	產品及形態		2025 1H(A)	2025 2H(F)
應用端	汽車		35%	35%
	智慧手持	手機	1%	1%
		IOT	5%	5%
		IT	35%	34%
	其他		24%	25%
技術面	軟硬板		31%	30%
	Anylayer		2%	2%
	HDI		45%	46%
	傳統板		15%	15%
	高頻板		7%	7%

核心產品

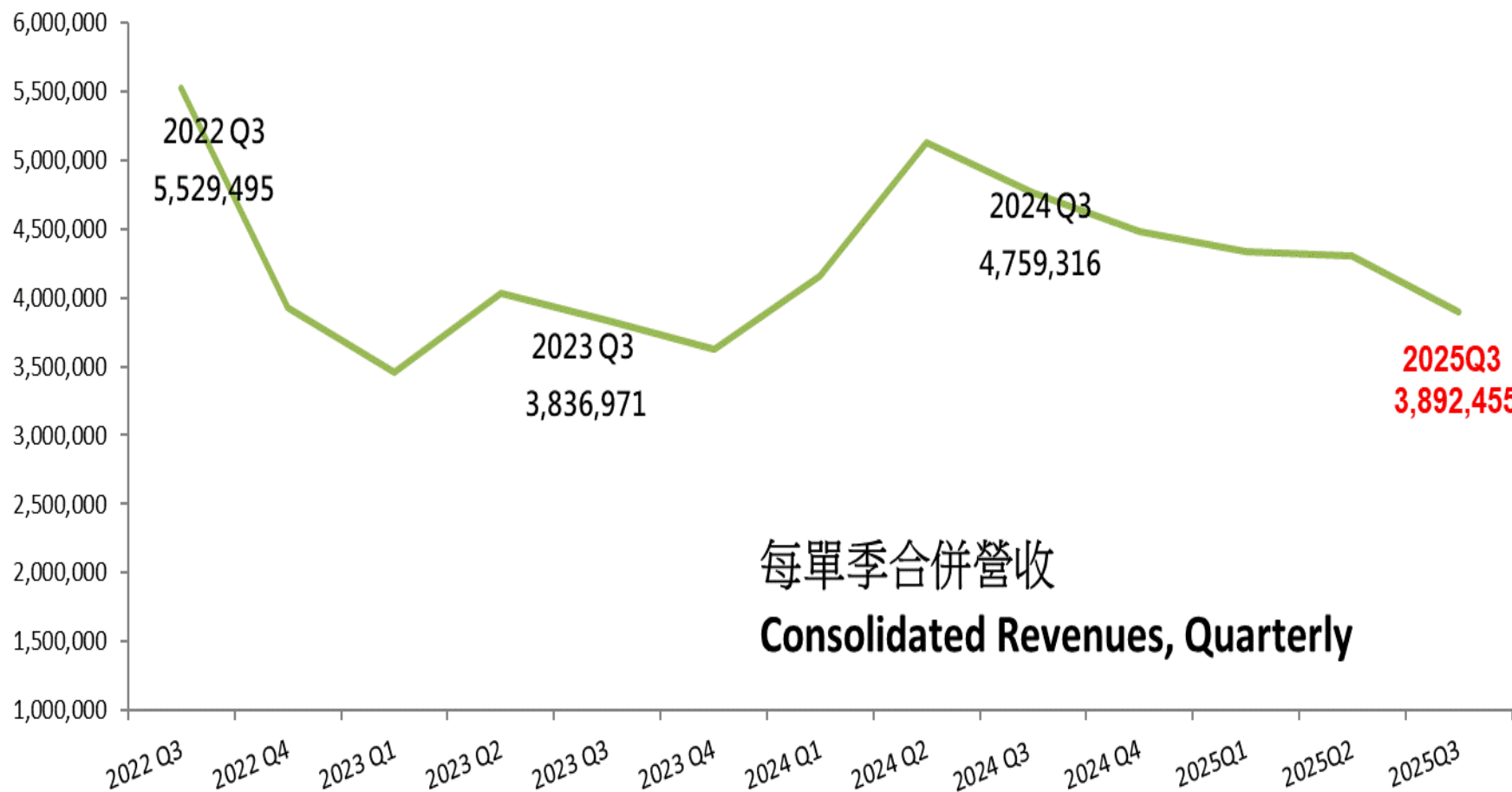
項目	產品及形態		2025(F)	2024A
應用端	汽車		35%	37%
	智慧手持	手機	1%	2%
		IOT	5%	6%
		IT	35%	28%
	其他		24%	27%
技術面	軟硬板		31%	32%
	Anylayer		2%	2%
	HDI		45%	49%
	傳統板		15%	10%
	高頻板		7%	7%

近5年度合併營收

Consolidated Revenues, annually

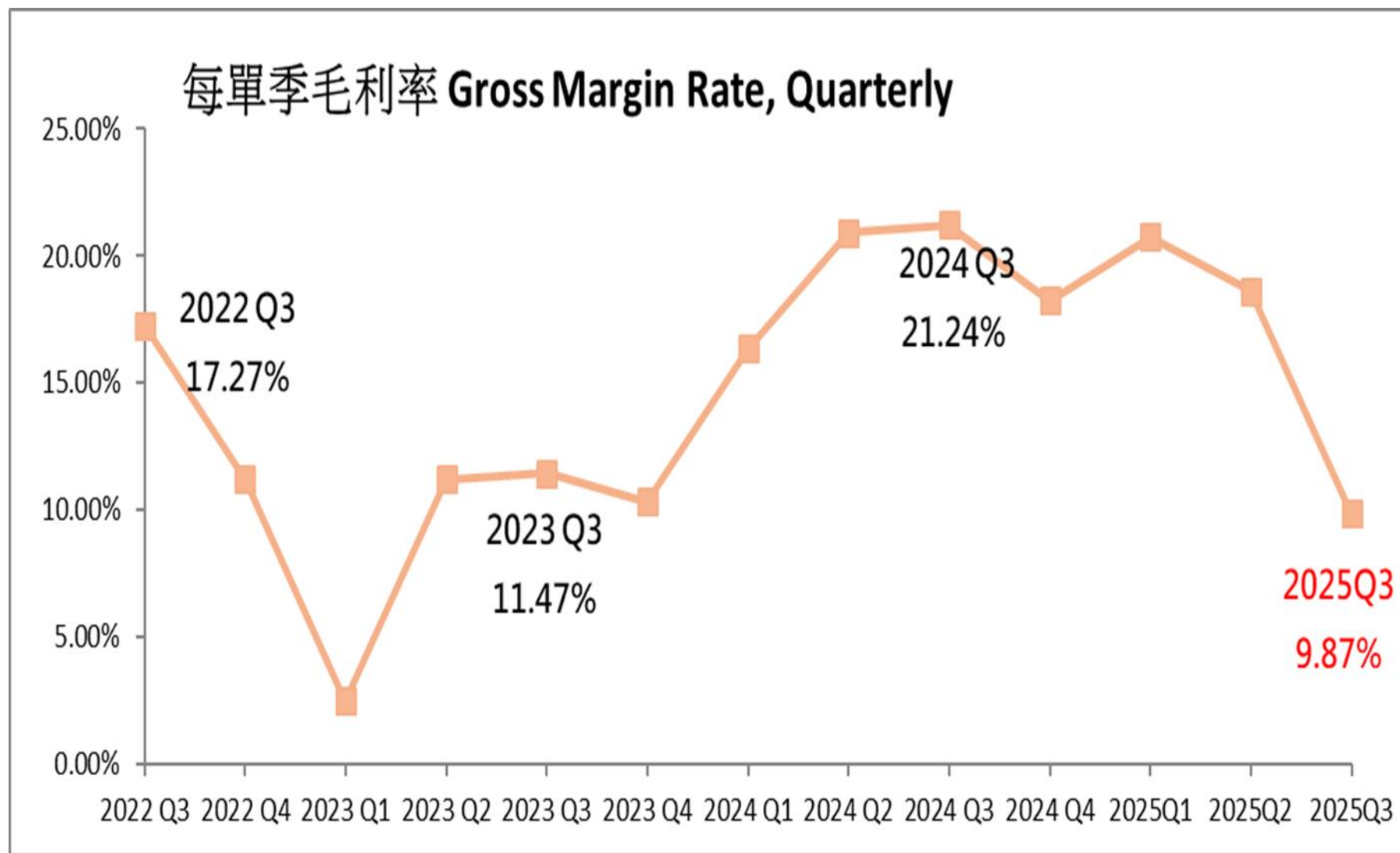


單位：新台幣仟元



每單季合併營收
Consolidated Revenues, Quarterly

單位：新台幣仟元



1. AI 伺服器進入第二波擴建週期，帶動高階 PCB 長期需求。Precedence Research 2024年更新指出全球 AI Server 市場將以 27.6% CAGR 成長至 2034；TrendForce 進一步預估 2025 年 AI Server 出貨量年增 近 40%，反映雲端業者持續擴建算力。
2. AI PC 從導入期邁向高速滲透，PC 結構重新洗牌。IDC 與 Canalys 上修 AI PC 需求，預估 2025 年 AI PC 出貨量上看 9,000 - 1 億台，2028 滲透率將達 60%。高層數、高速材料需求同步攀升。
3. HBM、GPU 等高階零組件短缺成為 AI 基礎建設瓶頸。Gartner 指出 HBM 供應將在 2025 - 2026 成為AI基礎建設的限制因子，使資料中心加快採用先進封裝與高速板材，PCB ASP 結構性提升。
4. 車用電子滲透率持續上升，帶動中長期穩健成長。S&P Global Mobility 預估 2025 年 EV 銷量可達 1,650 - 1,700 萬台，ADAS、BMS、OBC 持續推升車載 PCB 價值量。因應地緣政治與成本壓力，東南亞成為PCB產能轉移熱點。
5. PCB 產能全球重分布，東南亞成為新核心據點。因應美中競爭與客戶要求 China+1，TrendForce 指出 2024 - 2026 東南亞 PCB 產能 CAGR 將達 12 - 15%，高於全球平均，成為 AI Server 與車用 PCB 的主要新建產地。

供給 VS. 需求

1. 全球需求穩健回升，宏觀環境較年中走勢改善。IMF 預估 2025 年全球 GDP 成長 3.3%，通膨逐步回落；美聯儲啟動降息週期，有助提升IT與電子產業投資動能。
2. AI伺服器需求強勁，但材料與零組件供給不均。 HBM、CoWoS 產能緊張，使AI Server板材需求更集中於具備高速、高散熱能力的供應商；客戶對PCB良率要求顯著提高。
3. 車用電子需求持續增加，供應鏈分層更加明確。BMS、逆變器、雷達模組需求強勁，使厚銅板、IMS 板需求維持全年強勢；供應商從「供貨能力」轉向「可靠度與冗餘性」競賽。
4. 客戶對非中國產能要求提升，東南亞供給缺口浮現。北美科技企業要求提升非中供應比重，但東南亞高階 PCB 產能仍不足，造成「需求快速成長 / 能力建置未跟上」的供需缺口。
5. AI 與車用市場需求拉動主動備貨，全年訂單能見度提升高階 HDI、SLP、高頻材料等產品出貨週期延長，客戶傾向提前下單確保產能，使 PCB 產業進入較具可見度的需求階段。

營收及獲利的成長動能

1. 高速、高層數、高頻板成為獲利核心，AI Server ASP 結構性提升。AI 伺服器導入 800G/1.6T 交換器、先進封裝等架構，使 PCB 單位價值顯著上升，高階製程成為毛利主要來源。
2. AI PC 與穿戴裝置帶動新材料（LCP/MPI/BT）成長曲線。AI PC 對高速傳輸與低 DK/DF 的需求提高，帶動高層數 HDI 與 BT 板需求成長；AR/VR 導入柔性材料提升 FPC 市占。
3. 車載電子帶來穩定且具成長性的長期營運基礎。厚銅板、高散熱 IMS、雷達 RF 板等產品比重提升，有助改善產品組合並強化長期獲利結構。
4. 區域化生產提升客戶黏著度並形成價格護城河。泰國等地的新產能符合客戶「non-China」策略，使公司具備供應鏈韌性優勢，可提升 ASP 與長期合作深度。
5. 新興衛星通訊、航太級材料開啟高毛利新賽道。低軌衛星（LEO）需求推升 LCP/RF 板材，高附加價值產品比重提升，成為未來 3-5 年新的獲利突破點。

綠色耀華、環境永續

- 耀華以「積極創新、團結和諧、客戶導向、謹守誠信」為經營理念，奠定「永續企業」的發展根基，面對未來充滿挑戰的經營環境，在經濟、環境及社會議題上，規劃適切短、中及長期發展計畫，履行邁向永續發展的承諾及願景。
- 跟隨著ESG國際永續經營趨勢，耀華電子也規劃了一系列節能減碳策略，包括購買及自建再生能源，並訂定廠區減碳目標，積極接軌低碳製造趨勢，結合ICT科技推動智慧製造，往低碳企業的目標邁進。
- 耀華電子將持續秉持誠信經營態度及永續思維，接軌國際永續標準及系統，不斷精進自身永續能力，透過全員落實永續作為，並持續透過研發，提供以客為主、具創新的技術及製造服務，持續引領PCB產業向上提升，邁向永續發展願景。

Thank You !!!